

上海硅产业集团股份有限公司

2025 年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-153,000.00 万元到-128,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加-55,946.29 万元到-30,946.29 万元。

（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将出现亏损，约为-180,000.00 万元到-150,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加-55,693.84 万元到-25,693.84 万元。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）利润总额：-116,433.85 万元。归属于母公司所有者的净利润：-97,053.71 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-124,306.16 万元。

（二）每股收益：-0.353 元。

三、本期业绩变化的主要原因

1. 报告期内，全球半导体市场延续高增长态势，根据 WSTS 及 Techinsights 预测，全球半导体市场规模将达到 7,720 亿美元，与上年同期相比增长 22.5%，AI 应用及数据中心基础设施需求成为核心增长动力，但消费类电子、工业电子

等应用仍处于疲软状态，呈现同比微跌趋势。行业复苏的结构性分化，叠加部分领域库存影响，半导体硅片行业的整体市场环境仍具挑战。根据 SEMI 预测，报告期内，全球半导体硅片出货面积预计同比增长约 5.4%，其中，300mm 半导体硅片受益于先进制程与 AI 芯片需求，出货量持续攀升，产能利用率维持在较高水平；而 200mm 及以下半导体硅片受部分终端市场需求疲软影响，出货面积同比下滑约 3%，产能利用率水平相对较低。同时，报告期内全球半导体硅片（含 SOI 硅片）市场规模预计为 134 亿美元，虽同比微增 2.6%，但 SOI 硅片市场规模仅为 13.2 亿美元，同比下跌 13.6%，部分细分领域仍面临产品价格承压与产能消化压力。公司的经营表现与整体市场情况一致，其中 300mm 半导体硅片的销量较 2024 年同期增长超过 25%，但由于单价受市场竞争的影响有所下降，导致 300mm 半导体的收入较 2024 年同期涨幅约为 15%，而 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）的销量同比也略有增长，但由于部分产品的单价受市场影响仍在下降，特别是面向消费类电子市场为主的 200mm SOI 硅片受托加工服务受产品需求影响较大，200mm 及以下半导体硅片的收入水平基本持平，但毛利水平受到较大影响。

2. 公司前期并购的子公司 Okmetic OY 和上海新傲科技股份有限公司的主营业务为 200mm 及以下半导体硅片，受市场影响报告期内业绩水平不及预期，公司预估仍存在较大的商誉减值的可能性。

3. 由于公司的扩产项目仍处于产能爬坡阶段，其协同效应尚在释放过程中，前期的盈利水平尚未完全释放，同时公司始终坚持面向高规格产品、特殊规格产品以及国产化产业链建设等亟需解决的半导体硅片领域的重大战略任务的研发投入，虽然会对公司的短期盈利水平造成一定影响，但对公司的长期可持续发展带来有利的支持。

四、风险提示

公司最终计提的商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，最终评估结果与初步测算结果可能存在一定差异，敬请广大投资者注意投资风险。

五、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日